

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2025-008

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要



一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝箭电子	股票代码	301348
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张国光	林品旺	
办公地址	中国广东省佛山市禅城区古新路 45 号	中国广东省佛山市禅城区古新路 45 号	
传真	0757-63313400	0757-63313400	
电话	0757-63313388	0757-63313388	
电子信箱	zhangguoguang@fsbrec.com	linpinwang@fsbrec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1、报告期内公司所处行业情况

（1）所处行业

公司主营业务为半导体封装测试业务。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业下的电子器件制造业（行业代码：C397）。

（2）行业基本情况

①半导体行业概况

半导体是信息技术产业的核心以及支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。半导体产品主要应用于计算机、家用电器、数码电子、电气、通信、交通、医疗、航空航天等诸多领域，全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。近年来，半导体应用领域随着科技进步不断延展，5G、物联网、人工智能、智能驾驶、云计算和大数据、机器人和无人机等新兴领域蓬勃发展，为半导体产业带来新的机遇。

按照产品分类，半导体可以分为分立器件和集成电路两大类。分立器件是指具有单独功能的电子元件，主要功能为实现各类电子设备的整流、稳压、开关、混频、放大等，具有广泛的应用范围和不可替

代性。集成电路是指将一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。集成电路从功能、结构角度主要分为数字集成电路、模拟集成电路与数/模混合集成电路三类。



②全球半导体市场发展情况

2024 年，全球经济在多重挑战下继续缓慢复苏，但增长动能不足。主要央行走向货币宽松，纷纷开始进入降息周期。但地缘政治风险、贸易保护主义和供应链重构等问题仍对经济增长构成重大影响。

对于半导体行业而言，2024 年随着人工智能、AI 等科学技术的不断升级、普及和发展，下游应用需求持续增长，推动半导体市场规模不断扩大。

世界半导体贸易统计协会（WSTS）相关数据显示，2024 年第四季度全球半导体市场为 1,709 亿美元，同比增长 17%，较 2024 年第三季度环比增长 3%。2024 年全年市场规模为 6,280 亿美元，比 2023 年增长 19.1%。其中增长幅度最大的是存储芯片（增长 81%）和算力芯片（增长 16.9%）。展望 2025 年，WSTS 预测半导体市场整体仍将保持增长，增长幅度约为 11.2%，全球市场规模预计达到 6,970 亿美元。其中，算力芯片和存储芯片将继续成为增长的主要驱动因素。

Fall 2024	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Americas	134,377	186,635	215,309	-4.8	38.9	15.4
Europe	55,763	52,031	53,736	3.5	-6.7	3.3
Japan	46,751	47,410	51,866	-2.9	1.4	9.4
Asia Pacific	289,994	340,792	376,273	-12.4	17.5	10.4
Total World - \$M	526,885	626,869	697,184	-8.2	19.0	11.2
Discrete Semiconductors	35,530	31,546	33,377	4.5	-11.2	5.8
Optoelectronics	43,184	42,092	43,705	-1.6	-2.5	3.8
Sensors	19,730	18,732	20,034	-9.4	-5.1	7.0
Integrated Circuits	428,442	534,499	600,069	-9.7	24.8	12.3
Analog	81,225	79,433	83,157	-8.7	-2.2	4.7
Micro	76,340	79,291	83,723	-3.5	3.9	5.6
Logic	178,589	208,723	243,782	1.1	16.9	16.8
Memory	92,288	167,053	189,407	-28.9	81.0	13.4
Total Products - \$M	526,885	626,869	697,184	-8.2	19.0	11.2

数据来源：WSTS

③分立器件行业概况

半导体分立器件是半导体产业的基础及核心领域之一，其具有应用领域广阔、高成品率、特殊器件不可替代等特性。从市场需求看，分立器件受益于物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G 通信射频等市场的发展，具有较大的发展前景；从分立器件原材料看，随着氮化镓和碳化硅等第三代半导体材料的应用，半导体分立器件市场逐步向高端应用市场推进。随着我国分立器件企业产品技术的不断提升，国内的终端应用客户也更加趋向于实施国产化采购，给国内半导体分立器件企业带来更多的发展机遇。

芯查查企业 SaaS《2024 年 12 月及 2024 全年元器件供应链监测和风险预警报告》表明，分立器件的价格指数全年走跌，除 2024 年 3 月小幅回涨外，近 12 月内分立器件价格指数一直在基准线以下波动，价格低于 2022 年同期。总体来看，分立器件价格保持平稳，没有强劲终端需求，预计 2025 年分立器件价格指数继续保持低水位。分立器件交期指数全年逐步缩短，货品流通速度快，远低于基准线。消费电子行情有改善但动力不足，对于二极管、三极管、晶体管、IGBT 等需求不热。



数据来源：芯查查企业 SaaS（XCC.COM）

④集成电路行业概况

集成电路是信息处理和计算的基础，在科技革命和产业变革中发挥着关键作用。集成电路行业处于电子产业链的上游，其发展速度与全球经济增速正相关，呈现出周期性的波动趋势。从国家统计局和海关总署公布的相关数据来看，2024 年我国的集成电路出口保持了良好态势。其中，根据国家统计局公布的数据显示，2024 年我国集成电路产量为 4,514.2 亿块，同比增长 22.2%。其中累计出口数量为 2,981 亿个，同比增长 11.6%；累计出口金额为 11,352 亿元，同比增长 18.7%。

芯查查企业 SaaS《2024 年 12 月及 2024 全年元器件供应链监测和风险预警报告》表明，模拟器件的价格指数全年大幅走跌，2024 年上半年模拟市场景气度高，从 6 月开始，模拟器件跌至基准线以下，价格仍处于低位。国外模拟大厂如 TI、ADI、ST 等 Q3 模拟营收同比下降，从 TI 的 3.9%到 ST26.6%，工业和汽车市场是导致业绩大幅下降的主力军。模拟器件 12 月交期指数为 41.06，下跌至 2024 年最低点，库存持续下调，交期持续加快，终端客户去库存乏力。



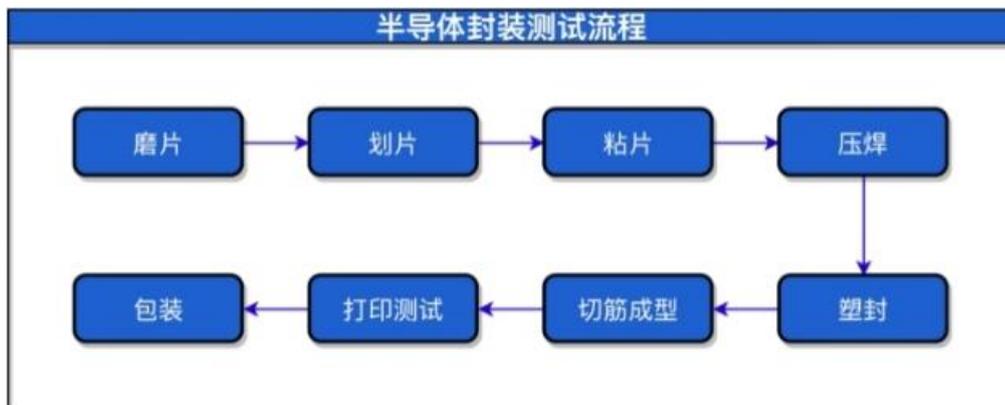
数据来源：芯查查企业 SaaS (XCC.COM)

根据中国半导体行业协会发布的《中国半导体行业发展状况报告（2024 年版）》显示，预计 2024-2026 年，在集成电路产业周期性回暖，下游应用领域需求持续增长等多重因素影响下，中国集成电路市场规模增速将逐年提升，到 2026 年市场需求将达到 22,935 亿元。

⑤ 半导体封测行业概况

公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品；产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护 IC、充电管理 IC 及 LED 驱动 IC 等集成电路产品。

封装环节是半导体封装和测试过程的主要环节。其功能主要包括两方面：首要功能是电学互联，通过金属 Pin 赋予芯片电学互联特性，便于后续连接到 PCB 板上实现系统电路功能；另一功能是芯片保护，主要是对脆弱的裸片进行热扩散保护以及机械、电磁静电保护等。



根据中国半导体行业协会发布的《中国半导体行业发展状况报告（2024 年版）》显示，封装和测试环节，2018-2023 年中国封测业复合增长率 6.0%。在传统封装向先进封装的转型的背景下，2023 年国内集成电路封测业规模呈现小幅回调，产业规模 2,932.2 亿元，同比下降 2.1%。但在先进封装的需求持续上升，国内晶圆级封装、2.5D/3D 封装市场不断增长，企业重点布局产业创新和先进封装技术。

根据《2021-2025 年中国半导体封测行业市场现状与发展前景报告》，预计中国半导体封测市场规模将从 2021 年的约 3,467 亿元增长至 2025 年的约 5,189 亿元，年复合增长率约为 7%。在增速方面，随着国内半导体产业的快速发展及全球产能转移持续的趋势，中国半导体封测市场将继续保持较高的增长速度。

⑥公司市场地位

公司是国内半导体器件专业研发制造商，依托强大的自主技术研发能力和丰富的客户资源，经过多年深入研发和市场拓展，已成为国内多家知名企业的核心供应商之一，同时公司也是华南地区半导体器件主要的生产基地之一。

2.2、报告期内公司从事的主要业务

（1）公司主营业务

公司主要从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护 IC、充电管理 IC 及 LED 驱动 IC 等集成电路产品。

半导体封装测试技术将继续向小型化、集成化、低功耗方向发展，在新兴市场和半导体技术进步的共同带动下，附加值高的封装技术将得到越来越多的应用，封装测试业市场有望持续向好。封装测试行业的创新主要体现为产品工艺上的创新，技术水平主要体现为产品生产的工艺水平。公司一直以来注重封装测试技术的研发升级，通过工艺改进和技术升级构筑市场竞争优势，掌握金属基板封装、全集成锂电保护 IC、功率器件封装、超薄芯片封装、半导体/IC 测试、高可靠焊接、高密度框架封装、系统级封装（SIP）、倒装技术（FC）等一系列核心技术，在封装测试领域具有较强的竞争优势。

公司目前已通过自主创新，在封测全流程中成功构建了数字化、智能化、自动化生产体系，通过智能系统与辅助系统的协同工作，已基本实现了从客户订单接收到整个产品生产的智能互联。公司具备了覆盖从 4 英寸到 12 英寸晶圆全流程的封测能力，并在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体、车规级功率器件封装等领域实现了科技成果与产业的深度融合。

作为一家国家级高新技术企业，公司长期以来都以技术创新作为核心驱动力，依托多年深厚的行业经验与自主研发实力，我们始终遵循“以客户需求为中心”的服务宗旨，获得行业内客户的广泛认可。经过多年发展与积累，公司客户群体遍布华南、华东、西北、西南等多个地区，产品广泛应用于家用电器、电源、电声等多个领域，并致力于深度挖掘高净值客户资源。多年来，公司与客户建立了长期而稳固的合作关系。

公司以广东省省级企业技术中心和工程技术研究开发中心，持续投入半导体封测技术的研发及创新；随着公司募投项目建设的推进，公司在新建的厂房大楼中布局了研发中心的建设，新的研发中心建设项目引入了先进的研发和检测设备，优化了研发环境，整合了现有的研发资源；同时，通过吸纳高端技术人才，旨在缩短新产品和新技术的研发周期，进一步增强公司的研发实力和科技创新能力，为公司的发展提供坚实的基础。

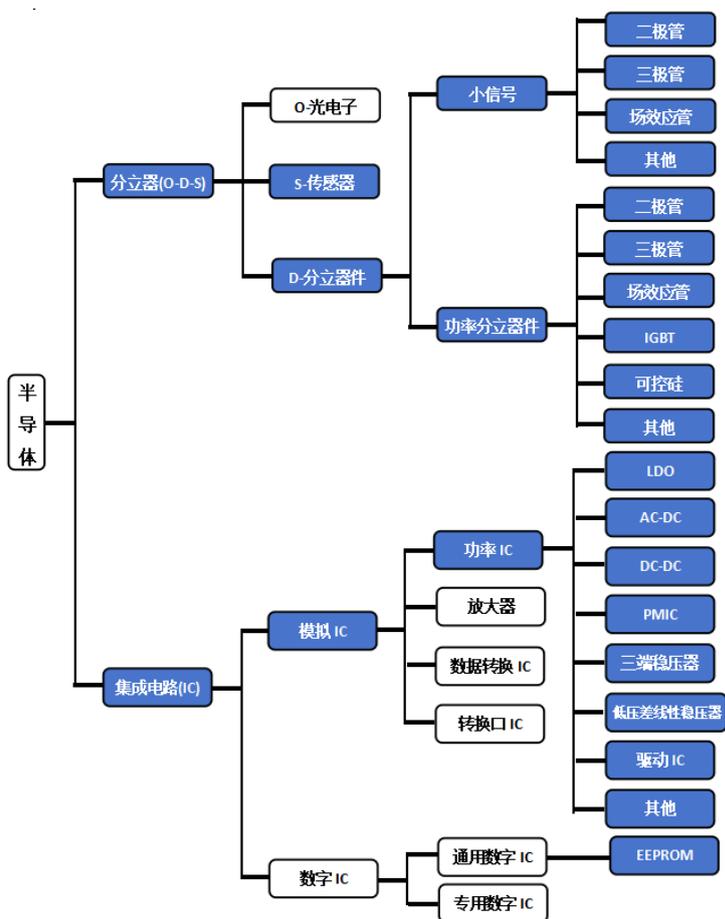
公司已荣获高新技术企业、国家知识产权优势企业等资质及荣誉。公司曾多次荣获广东省科学技术奖、佛山市科学技术奖等省、市科技奖项。报告期内，公司荣获广东省电子信息行业协会颁发的标杆企业称号，以及佛山市人民政府颁发的佛山市政府质量奖及佛山市科技领军企业（创新实力）两大殊荣。

截至报告期末，公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系标准认证、GB/T29490 知识产权管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证及 ESD S20.20 静电防护体系标准认证。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（2）公司的主要产品和服务

公司主要为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品，产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护充电管理 IC 及 LED 驱动 IC 等集成电路产品。公司主营业务产品如下：



注：图中标蓝的产品为公司主营业务产品

①分立器件产品

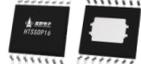
公司分立器件产品涉及 50 多个封装系列。按照功率划分，公司分立器件产品包括功率二极管、功率三极管、功率 MOS 等功率器件和小信号二极管、小信号三极管等小信号器件产品；按照具体产品类别划分，公司分立器件产品包括开关二极管、稳压二极管、整流二极管、肖特基二极管、快恢复二极管、ESD 保护二极管、瞬态抑制二极管、数字三极管、小信号三极管、功率三极管、平面型 MOSFET、沟槽型 MOSFET、屏蔽栅型 MOSFET、超结型 MOSFET 等产品；按照封装类型划分，公司分立器件产品主要封装形式包括 TO、SOT、SOP、DFN、PDFN、SMA、SMAF、SMB、SMBF、SMC、ABS、ABF、MBF、TOLL 等。具体情况如下：

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式				
分立器件	三极管	音频三极管	信号放大、信号开关、功率放大器等	消费类电子	电源、显示器、电话机、机顶盒等	封装产品规格齐全，功率器件采用创新结构设计。在产品设计上具有客户配套服务优势					
		普通三极管					TO-220F	TO-220	DFN1006-3L	SOT-323/363	
		数字三极管									
		高反压三极管					TO-252	SOT-89	SOT-23	TO-3P	
	二极管	肖特基二极管	电源整流、电流、流向、稳压、关等	消费类电子、通安汽车等	电源、家电、数码产品等	采用沟槽技术，采用铜桥封装工艺，产品具有优异的性能指标及电学参数					
		ESD\TVS					SMAF/SMBF	TO-252	DFN1006-2L	DFN0603	
		稳压二极管									
		快恢复二极管					SOD-323	SOD-123FL	SMA/B/C	TO-277	
		整流桥									
							MBF	MBS	ABF	ABS	
	场效应管	平面型 MOSFET	信号放大、负载开关、控制率等	消费类电子、安防、通安汽车等	电源、充电器、电池保护、马达驱动、负载开关等	采用有平面、沟槽和超结芯片工艺产品，采用铜桥封装工艺，产品具有优异的性能参数					
		沟槽型 MOSFET					PDFN3×3	TO-252	SOP-8	SOT23-3/6	
		屏蔽栅型 MOSFET									
		超结型 MOSFET					PDFN5×6	DFN2×2	DFN8×8-3L	DFN1006-3L	

②集成电路产品

在集成电路领域，公司主要产品包括 SOT、SOP、DFN、QFN 等封装产品涉及 50 多个系列，按照产品类别划分，主要产品包括 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护 IC 及 LED 驱动 IC 等。具体情况如下：

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
集成电路	电源管理	LED 驱动 IC	通过交流转换成直流，提供给 LED 器件稳定可控的恒定电流，同时保证有较好的抗干扰能力	广泛应用于照明电路、汽车电子等	日光灯、球泡灯、筒灯、射灯、面板灯、汽车转向灯、路灯等	为优化芯片功能的自主设计框架，多芯片互联焊接技术，高密度焊线技术，多站点高效率 IC 的精准测试技术，高可靠性的封装技术				
							SOP-7/8	ESOP-8	TO-252	SOT89-3/5
										
							SOT23-3/5/6			
		DC-DC	直流电压转换器，为线路提供稳定电压，起到噪声隔离、安全隔离等	广泛应用于消费电子、汽车电子等	调制解调器、通信设备（平板电脑、数码相机等）	封装产品规格齐全，在粘片、压焊积累了深厚的技术沉淀，采用倒装技术，提供高功率密度、高可靠性的产品				
							SOT23-5/6	SOP-8	DFN1.6x1.2-8L	TSOT23-5/6
										
							DFN2x2-6/8L	DFN3x2-8L	DFN3x3-6/8/10L	
		锂电保护 IC	为锂离子电池（可充电）提供过充、过放、过流及短路保护，使其安全可靠为其他电子设备提供稳定的供电电压	广泛应用于汽车电子、消费电子、网络通信等	笔记本电脑、平板电脑、手机、数码相机、无人飞机等	采用高度集成的芯片集成技术，将保护 IC 和 MOS 及外围电阻、电容等几个不同的器件，通过芯片工艺技术集成为一个芯片，为客户贴片组装降低成本，采用片式超小型封装				
							DFN1010-4L	DFN2x2-6/8L	DFN3x3-6/8/10L	ESOP-8
										

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
							SOT23-3/5/6			
		稳压 IC	具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等	消费类电子、网络通信、安防等	数码产品、TV、家电、电脑等	具有负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等功能，低输出噪声、低静态电流及低于 100mV 的压差				
							SOT-223	SOT23-3/5	SOT89-3L	TO-252
		AC-DC	交流转换成直流	消费类电子、安防、网络通信等	开关电源、充电器、适配器、电源控制板等	采用集成封装，内置高压功率开关器件，具备输出过压保护功能，欠压锁定保护功能，过温保护功能				
							SOP-7/8	HTSSOP16	QFN3×3-16/20L	QFN4×4-16/24/32L
		多通道阵列 TVS	为电子产品及通信系统提供防护静电及抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车电子等	高清多媒体接口、触摸屏等电子设备端口处，通信设备端口及基站等	通过新设计的高密度框架使单位成本下降 15%，塑封生产效率提升 50%，去氧化和成型分离生产效率提升 100%，低电容、低钳位电压，为国内知名厂家配套服务				
							SOT23-6		SOP-8	

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,874,396,635.95	1,917,266,563.60	-2.24%	1,121,237,686.95
归属于上市公司股东的净资产	1,526,702,465.97	1,567,590,701.60	-2.61%	725,216,318.31
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	713,059,932.31	736,580,879.68	-3.19%	751,633,605.95
归属于上市公司股东的净利润	15,111,764.37	58,368,765.24	-74.11%	71,424,649.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,892,252.47	42,395,530.89	-74.31%	69,168,448.44
经营活动产生的现金流量净额	139,038,717.12	92,607,221.44	50.14%	95,995,329.83
基本每股收益（元/股）	0.08	0.35	-77.14%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.35	-77.14%	0.48
加权平均净资产收益率	0.98%	5.75%	-4.77%	9.85%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,776,393.01	185,234,603.78	182,031,978.48	208,016,957.04
归属于上市公司股东的净利润	-8,305,957.50	468,790.65	7,931,376.44	15,017,554.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,214,789.00	266,455.51	5,719,640.98	14,120,944.98
经营活动产生的现金流量净额	10,014,641.71	17,392,372.39	28,763,931.66	82,867,771.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,150	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---	--------------------	---

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王成名	境内自然人	15.83%	31,669,430.00	31,669,430.00	不适用	0.00
陈湛伦	境内自然人	9.86%	19,716,218.00	19,716,218.00	不适用	0.00
上海银圣宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.71%	17,411,104.00	0.00	不适用	0.00
张顺	境内自然人	7.55%	15,107,565.00	15,107,565.00	不适用	0.00
舒程	境内自然人	3.27%	6,538,902.00	0.00	不适用	0.00
广东比邻投资基金管理有限公司一比邻创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.04%	6,082,902.00	0.00	不适用	0.00
赵秀珍	境内自然人	0.98%	1,958,549.00	1,468,912.00	不适用	0.00
曾周洁	境内自然人	0.82%	1,643,850.00	0.00	不适用	0.00
袁凤江	境内自然人	0.78%	1,555,648.00	1,166,736.00	不适用	0.00
陈鹏	境内自然人	0.54%	1,076,853.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		王成名、陈湛伦、张顺为一致行动人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

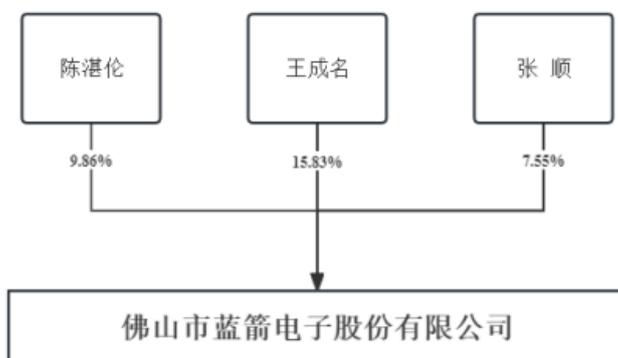
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）权益分派顺利完成

为保持股东回报水平的长期、稳定，公司综合考虑了中长期发展规划和短期生产经营的实际情况，在保障公司现金流的稳定性和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕。公司以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计派发现金红利总额为人民币 56,000,000 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2024-036）。

（二）对外投资

公司于 2024 年 9 月 30 日和 2024 年 11 月 26 日，分别对外参股出资设立佛山市星通半导体有限公司和广东兴睿微电子有限公司。其中，佛山市星通半导体有限公司注册资本 7,000 万元人民币，公司持股比例为 49%；广东兴睿微电子有限公司，注册资本 8,000 万元人民币，公司持股比例为 35%。以上事项已完成工商注册登记手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和本公司《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审批。